

2021年2月8日

大阪工場で最先端プロセス向け半導体フォトレジストの生産能力を増強

住友化学は、このたび、液浸 ArF（フッ化アルゴン）、EUV（極端紫外線）などの最先端プロセス向け半導体フォトレジストについて、大阪工場（大阪市此花区）の製造ラインを増設し、生産能力を引き上げることといたしました。新製造ラインの稼働開始は2022年度上期を予定しています。

フォトレジストは、半導体製造工程におけるパターン形成に使用される感光性樹脂です。住友化学は、各種ファインケミカル事業で培った有機合成技術をベースに高い製品設計・評価技術を確立し、大阪工場を中心とした製造・研究・販売集約によるタイムリーな顧客対応力などを生かして事業を拡大してきました。特に、微細化工程で主として使用される液浸 ArF 露光用レジストについては、性能優位性と品質安定性により世界的に高いシェアを占めています。また、新たな光源である EUV 露光用レジストについても、採用が決定している有力顧客の量産化スケジュールに応じた出荷の増加を見込むとともに、着実な新規受注獲得に向けてさらなる微細化ニーズに沿った開発を進めています。19年度には、先端フォトレジストプラントを新設したことに加え、開発効率向上や品質保証体制強化を目的としたクリーンルームの新棟建設および新規評価装置の導入計画を決定しました。これら直近3年間の投資額は100億円を超え、一連の供給体制整備の一部は経済産業省の「サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金」の対象事業に採択されました。

半導体デバイス市場は、5G スマートフォン需要の増加に加え、在宅勤務などライフスタイルの変化に伴いパソコンやデータセンター関連機器の需要増加を背景に伸長を続けており、液浸 ArF をはじめとする先端フォトレジストの需要は今後も年率6%の拡大が見込まれています。そのため、住友化学は今回、19年度に設置した先端フォトレジストプラントに新たな製造ラインを増設し、同プラントの生産能力を約4倍に引き上げる決定をいたしました。同じく22年度上期に完成予定である開発・評価体制強化に向けた新棟建設と合わせ、22～24年度の次期中期経営計画期間において飛躍的な事業規模拡大を目指します。なお、データ通信のさらなる高速化や大容量化などにより、半導体市場は今後も継続的な成長が見込まれ、25年頃には当社の生産能力は逼迫が予想されるため、長期的な需要を見据えて一層の体制強化を検討していく考えです。

住友化学は、中期経営計画において「ICT」を重点分野の一つと位置付けています。引き続き、フォトレジストをはじめとする半導体材料事業の成長を通じて、Society5.0に代表されるスマート社会やスマートモビリティの実現に欠かせない半導体産業の発展に貢献してまいります。

以上